

## บทที่ 2

### ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

#### 2.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผิวเคลือบกันแสงสะท้อน [4]

อุปกรณ์ที่ศูนย์ศาสตร์ต่างๆ ที่ถูกผลิตขึ้นมาจากการออกแบบใดๆ นั้น โดยส่วนมากแล้วจะมีการเคลือบผิวด้วยวัสดุชนิดหนึ่ง เพื่อให้การสะท้อนและการส่งผ่านแสงที่เกิดขึ้นบริเวณผิวหรือขอบของตัวกลางนั้นมีการเปลี่ยนแปลง กล่าวคือ เมื่อแสงซึ่งเคลื่อนที่อยู่ในตัวกลางชนิดหนึ่งตกกระทบกับผิว หรือขอบของตัวกลางอีกชนิดหนึ่งซึ่งมีสมบัติเชิงแสงที่แตกต่างกันแล้วนั้น ย่อมมีส่วนของแสงที่สะท้อนกลับไปในตัวกลางอันเดิม และมีส่วนที่ส่งผ่านไปในตัวกลางอันใหม่ซึ่งจะเป็นส่วนที่แสงหักเหตามสมบัติของแสง แต่จะเป็นส่วนมากหรือน้อยนั้นขึ้นกับสมบัติผิวหรือขอบของตัวกลางอันที่แสงตกกระทบเปรียบเทียบกับตัวกลางอันเดิมนั่นเอง

ผิวเคลือบกันแสงสะท้อนชนิด Single layer ที่ถูกทำการเคลือบบนผิวชั้นสเตรตซึ่งเป็นแก้ว, แก้วควอทซ์ ฯลฯ เมื่อมีแสงนาตเกรทกระทบยังผิวของวัสดุ โดยการสะท้อนแสงที่เกิดขึ้นที่รอยต่อระหว่างอากาศ/ฟิล์มนาง กับการสะท้อนที่รอยต่อระหว่างฟิล์มนางและชั้นสเตรต หากมุมสะท้อนทั้ง 2 รวมกันแล้วได้  $180^\circ$  แล้วจะทำให้เกิดการแทรกสอดแบบหักล้างทำให้การสะท้อนของแสงที่เกิดขึ้นถูกทำลายไปเหลือแต่การส่งผ่านแสงนั่นเอง กล่าวคือ การเคลือบผิวด้วยวัสดุกันแสงสะท้อนนี้จะถูกผลิตขึ้นเพื่อลดหรือขัดการสะท้อนของแสงที่ขอบของตัวกลาง โดยผิวเคลือบกันแสงสะท้อนนี้ได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้กันอย่างกว้างขวาง ตัวอย่างเช่น เชลล์สูริยะ หศนศาสตร์และกระทบ เป็นต้น

#### 2.1.1 ความหนา ( $d_1$ )

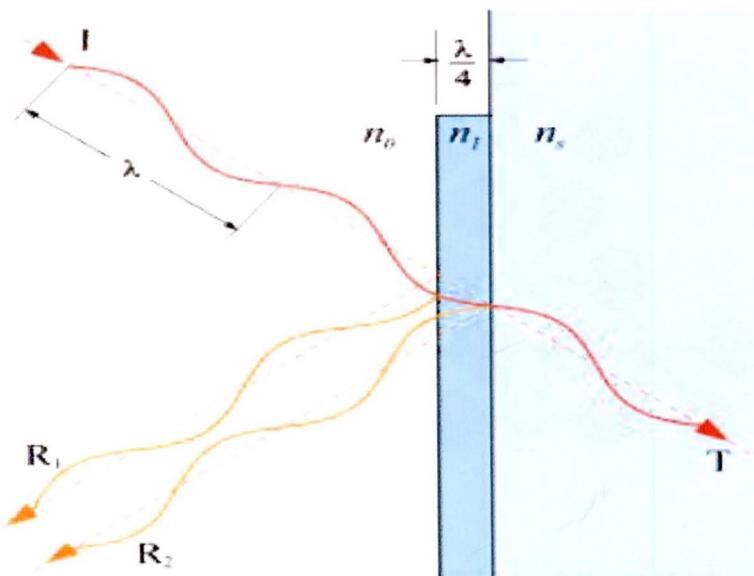
ความหนาชั้นผิวเคลือบกันแสงสะท้อนควรจะมีค่าที่เป็นไปตามกฎ “ $1/4$  ของความยาวคลื่นแสง” กล่าวคือ ถ้าแสงที่เราพิจารณา มีความยาวคลื่นเป็น  $\lambda$  และค่า  $n_1$  หักเหแสงของชั้นผิวเคลือบกันแสงสะท้อนเป็น  $n_1$  ความหนาที่เหมาะสมของชั้นผิวเคลือบ คือ

$$d_1 = \frac{\lambda}{4n_1} \quad (2.1)$$

### 2.1.2 ดัชนีหักเหแสง ( $n_1$ )

ชั้นผิวเคลือบกันแสงสะท้อนความมีความโปร่งใสที่ดีและมีดัชนีหักเหแสง  $n_1$  ในอุคณฑ์คือ ความมีค่าเท่ากับค่าเฉลี่ยของผลคูณของค่าดัชนีหักเหแสงของอากาศและของตัวกลางตัวที่ 2 ดังนี้

$$n_1 = \sqrt{n_0 n_2} \quad (2.2)$$

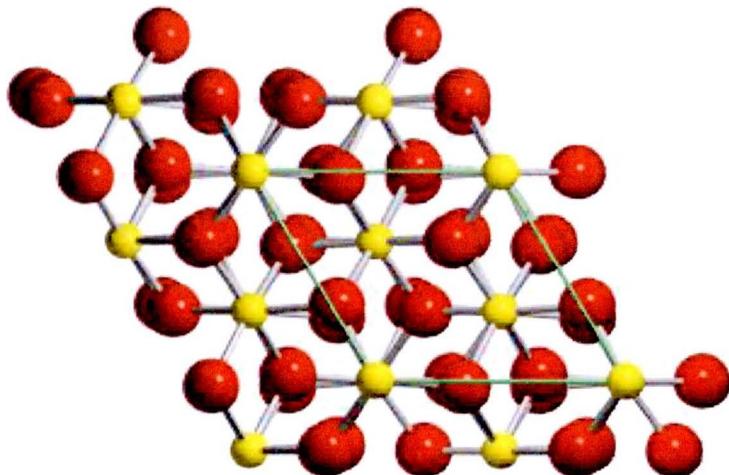


รูป 2.1 ปรากฏการณ์การแทรกสอดของแสงที่เกิดขึ้นในชั้นผิวเคลือบกันแสงสะท้อนที่มีความหนาเท่ากับ  $\frac{1}{4}$  ของความยาวคลื่นแสง [17]

ด้วยเงื่อนไขดังกล่าวทั้ง 2 ข้อนี้จะทำให้ความเข้มของแสงสะท้อนมีค่าน้อยที่สุด โดยเงื่อนไขข้อที่ 1 นั้นจะทำให้เฟสของแสงที่สะท้อนที่ผิวน้ำสุดและที่สะท้อนที่ผิwtากกลางที่ 2 มีค่าแตกต่างกัน  $180^\circ$  ดังนั้นจึงทำให้แสงที่สะท้อนทั้ง 2 แห่งนี้ไปทำการแทรกสอดแบบหักล้างกัน เมื่อสะท้อนออกจากผิวเคลือบกันแสงสะท้อน จึงทำให้แสงสะท้อนสูญเสียความเข้มน้อยที่สุด

## 2.2 ความรู้เบื้องต้นเรื่องอะลูมิเนียมออกไซด์ ( $\text{Al}_2\text{O}_3$ ) [5]

อะลูมิเนียมออกไซด์หรืออะลูมินา เป็นสารประกอบระหว่าง Al กับ O มีสูตรโมเลกุลคือ  $\text{Al}_2\text{O}_3$  โครงสร้างผลึกของอะลูมิเนียมออกไซด์เป็นแบบ Rhombohedral ดังแสดงในรูปที่ 2.2



รูป 2.2 โครงสร้างผลึกของอะลูมิเนียมออกไซด์ [24]

อะลูมิเนียมออกไซด์มีคุณสมบัติเฉพาะ คือ มีจุดหลอมเหลวประมาณ 2050 องศาเซลเซียส มีความหนาไฟสูงมากกว่า 2000 องศาเซลเซียส มีความแข็ง 9 Mohs' scale ทำให้ทนต่อแรงขีดข่วนสูง ทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิฉันพลันได้ดี เนื่องจากมีอัตราการขยายตัวต่ำ และมีการนำความร้อนได้ดี

## 2.3 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยี [6]

คำว่า “นาโน” มีรากศัพท์มาจากภาษากรีก แปลว่า “คนแคระ” หมายถึง หนึ่งในพันล้านหน่วย หรือหนึ่งในพันล้านส่วน แต่ที่นิยมเรียกกันจนติดปาก คือ นาโนเมตร (nanometre) ซึ่งหมายถึงสิบกำลังลบเก้าเมตร หรือ 1 ส่วนพันล้านของ 1 m หรือเรียกในอังกฤษว่า แองสตروم

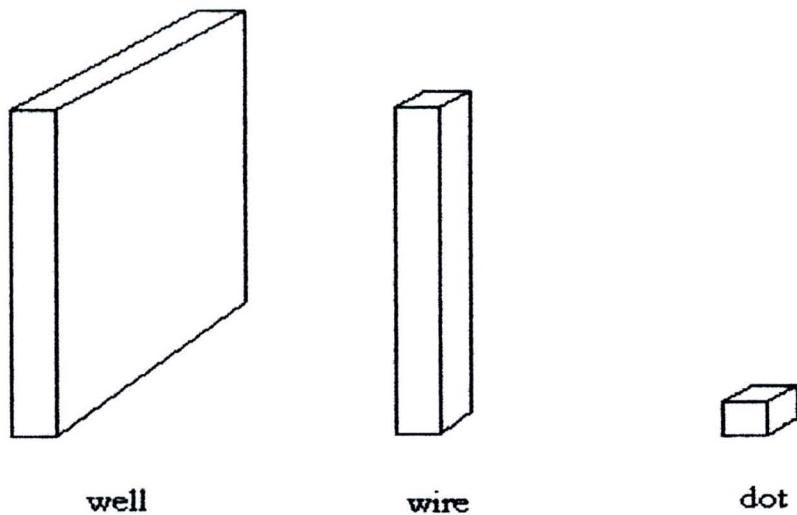
ยูนิต (angstrom unit) ดังนั้น “นาโนเทคโนโลยี” คือ วิทยาการประยุกต์เบนงใหม่ที่ว่าด้วยเรื่องของเทคโนโลยีในการประกอบและผลิตสิ่งต่างๆ ขึ้นมาจากการจัดเรียงอะตอม หรือโมเลกุลเข้าด้วยกันด้วยความแม่นยำและถูกต้องในระดับนาโนเมตรหรือขนาด 1 ในพันล้านส่วนของ 1 m โดยเป็นการผสมผสานของวิทยาศาสตร์หลายแขนง เช่น ชีววิทยา พิสิกส์ ชีวเคมี วิศวกรรมศาสตร์สาขาหุ่นยนต์ และเครื่องจักรกล

นาโนศาสตร์ (nanoscience) หมายถึง การศึกษาหลักการพื้นฐานของโมเลกุลและโครงสร้างขนาด 1 ถึง 100 nm (อักษรย่อ น.ม. –nm) โครงสร้างเหล่านี้เรียกโดยรวมว่า “โครงสร้างนาโน (nanostructures)” โครงสร้างนาโนไม่เพียงเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กกว่าสิ่งใดๆ ที่มนุษย์เคยประดิษฐ์ขึ้นมาก่อนหน้านี้ แต่ยังเป็นสิ่งที่เล็กจิวที่สุดที่เราสามารถสร้างขึ้นมาได้ถ้าอยากรู้ว่า 1 น.ม. จิวขนาดไหน ก็ลองเปรียบเทียบกับพมของคนเราคุณภาพว่า 1 nm มีขนาดประมาณ 1/50,000 ส่วนของเส้นพมของคนเรา หรือเส้นพมนิยนาดประมาณ 50,000 nm หรือเท่ากับอะตอมของไฮโดรเจน 10 ตัวรวมกัน ซึ่งสิ่งเล็กจิวที่สุดที่มนุษย์สามารถมองเห็นได้โดยไม่ต้องมีเครื่องช่วยมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 10,000 nm

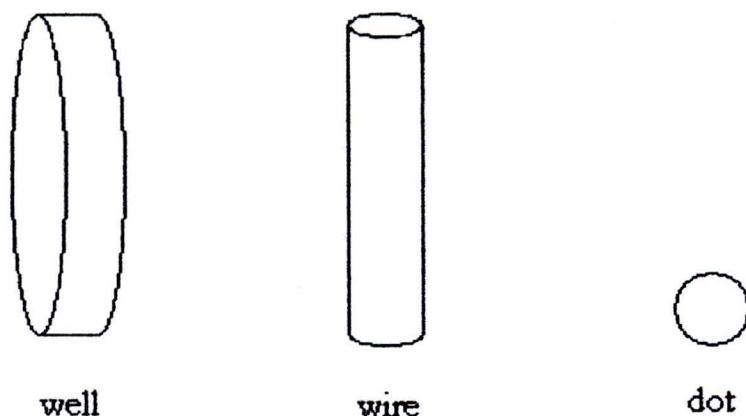
## 2.4 ลักษณะโครงสร้างทางกายภาพของวัสดุ nano [7]

นาโนวัสดุเป็นวัสดุที่มีขนาดเล็กในระดับนาโนเมตร (หนึ่งในพันล้านเมตร) โดยทั่วไปลักษณะของวัสดุ nano นั้นจะมีอยู่ 3 แบบคือ

1. quantum well เป็นวัสดุที่มีขนาดเล็กลงในระดับนาโนเมตรเพียงหนึ่งมิติ แต่อีกสองมิติ ยังมีขนาดใหญ่
2. quantum wire เป็นวัสดุที่มีขนาดเล็กลงในระดับนาโนเมตรสองมิติ แต่อีกหนึ่งมิติยังมีขนาดใหญ่
3. quantum dot เป็นวัสดุที่มีขนาดเล็กลงในระดับนาโนเมตรทั้งสามมิติ โครงสร้างในระดับนาโนวัสดุแสดงดังรูปที่ 2.3 และรูปที่ 2.4



รูป 2.3 แสดงโครงสร้างในระดับนาโนที่มีรูปร่างแบบ rectangular



รูป 2.4 แสดงโครงสร้างในระดับนาโนที่มีรูปร่างแบบ curvilinear

## 2.5 ผลของขนาดที่เกี่ยวข้องกับสมบัติของวัสดุ nano [7]

เมื่อวัสดุที่มีขนาดเล็กลงในระดับนาโนเมตร จะส่งผลทำให้พื้นที่ผิวมีขนาดเพิ่มมากขึ้น และทำให้สมบัติของสารนั้นเปลี่ยนไป ซึ่งผลเกี่ยวข้องที่สามารถเปลี่ยนสมบัติของวัสดุในระดับ quantum มีดังนี้

1. Size effects
2. Conduction Electrons and Dimensionality

3. Fermi Gas and Density of States
4. Potential Wells
5. Partial Confinement
6. Properties Dependent on Density of States

### 2.5.1 Size effects

จะกล่าวถึงคุณสมบัติของระบบที่มีขนาดเล็กมากๆ ตัวอย่าง เช่น เซมิคอนดักเตอร์ GaAs มีค่าคงที่แล็ตทิช  $0.565 \text{ nm}$  และมีปริมาณต่อหน่วยน้ำยาเซลล์เป็น  $(0.565)^3 = 0.18 \text{ nm}^3$  ในหนึ่งหน่วยเซลล์จะมี Ga และ As อยู่ 4 อะตอม ซึ่งจะเรียงตัวกันแบบ face center cubic (FCC) ซึ่งจะทำให้อัตราการของ Ga อยู่ที่ศูนย์กลางของ tetrahedron ของ As ซึ่งจะสร้างกลุ่มของ  $\text{GaAs}_4$  ในทำนองเดียวกันก็จะสร้างกลุ่มของ  $\text{AsGa}_4$  ด้วย และจะมีจำนวนอะตอมแต่ละชนิดทั้งสิ้น 22 atom/nm<sup>3</sup> ดังนั้น 1 quantum dot แบบลูกบาศก์ซึ่งมีขนาด  $10 \text{ nm}$  จะมีหน่วยเซลล์ทั้งสิ้น  $5.56 \times 10^3$  หน่วยเซลล์ สำหรับจำนวนอะตอมที่อยู่บนผิวถ้าสารตั้งต้นมีโครงสร้างเป็น FCC และในหนึ่ง quantum dot บรรจุหน่วยเซลล์ได้ทั้งสิ้น  $n^3$  หน่วยเซลล์ จะสามารถหาจำนวนอะตอมบนผิว ( $N_S$ ) ได้

$$\text{โดย } N_S = 12n^2$$

$$\text{จำนวนอะตอมทั้งหมด } N_T = 8n^3 + 6n^2 + 3n$$

ขนาดของลูกบาศก์  $d = na$  (เมื่อ  $a$  คือค่าคงที่ของแล็ตทิช GaAs =  $0.565 \text{ nm}$ , ZnS =  $0.541 \text{ nm}$ )

อัตราส่วนระหว่างจำนวนอะตอมที่อยู่บนผิวต่อจำนวนอะตอมทั้งหมด ( $N_S/N_T$ ) จะมีค่ามากเมื่อ  $n$  มีค่าน้อยๆ (คือมีขนาดเล็กมาก) ซึ่งเปอร์เซ็นต์ของอะตอมบนผิวที่มาก enough ทำให้สมบัติของสารที่มีขนาดเล็กมากๆเปลี่ยนไปจากสารที่มีขนาดใหญ่

ในด้านนำหรือสารกึ่งด้านนำ เมื่ออิเล็กตรอนอิสระเคลื่อนที่จะมีการกระเจิงเกิดขึ้นเนื่องจากสิ่งแปรปรวนที่อยู่ภายใน ซึ่งระยะทางที่อิเล็กตรอนเคลื่อนที่ได้ก่อนการกระเจิงแต่ละครั้ง (เป็นค่าโดยเฉลี่ย) เรียกว่า mean free path ซึ่งค่า mean free path ของโลหะแต่ละชนิดขึ้นอยู่กับปริมาณของสิ่งเจือปน โลหะทั่วไปจะมีค่า mean free path ประมาณ 2-50 nm ในสารตัวอย่างที่มีความ-

บริสุทธิ์มากๆ ก็จะมีความยาวมากกว่านี้

ค่าสภารต้านทานของตัวนำและสารกึ่งตัวนำที่เป็น polycrystalline ซึ่งประกอบขึ้นจาก microcrystalline ซึ่งขนาดใหญ่กว่าค่า mean free path จะคล้ายกับการต่อรวมกันของตัวต้านทาน ซึ่งจะทำให้ค่าสภารต้านทานเพิ่มมาก เนื่องจากสิ่งเปลกปลอมภายในแผลตพิชจะเป็นตัวขัดขวางการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนตัวนำ และจะเป็นข้อจำกัดของ mean free path ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดค่าสภารต้านทานด้วย แต่ถ้าหากขนาดของ microcrystalline มีค่าเข้าใกล้หรือน้อยกว่า mean free path จะทำให้นางส่วนนีขนาดเด็กเกินกว่าที่จะมีสิ่งเปลกปลอมภายใน จึงทำให้สภารนำไฟฟ้าสูง ตัวอย่างของสิ่งเปลกปลอมเช่น ช่องว่างภายในแผลตพิช ความเสียหายของแผลตพิชที่บริเวณขอบ เป็นต้น

Size effects อีนๆ สำหรับ quantum dot ขนาด  $100\text{ nm}$  โดยทั่วไปจะมีอิเล็กตรอนตัวนำเพียง  $10^{-1}\text{-}10^3$  ตัว ความหมายของอิเล็กตรอน  $10^{-1}$  ตัว ก็อท ใน quantum dot 10 ก้อน อาจมีปรากฏการณ์ single electron tunneling

### 2.5.2 Conduction Electrons and Dimensionality

โดยปกติการศึกษาด้านอิเล็กทรอนิกส์ใน 3 มิติ ไม่ว่าขนาดใหญ่หรือเล็กเราจะพิจารณาว่า อิเล็กตรอนเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระภายในตัวนำ เช่น ลวดทองแดง เนื่องจากขนาดของตัวกลามใหญ่มากเมื่อเทียบกับขนาดของอะตอม แต่หากขนาดของลวดทองแดงมีด้านใดด้านหนึ่ง (หรือมากกว่า) เล็กลงจนเข้าใกล้ระยะห่างระหว่างอะตอมภายในแผลตพิช ซึ่งจะทำให้อิเล็กตรอนอาจจะถูกจำกัดขอบเขตของการเคลื่อนที่ ตัวอย่างเช่น พิจารณาแผ่นทองแดงที่มีความยาว  $10\text{ cm}$  กว้าง  $10\text{ cm}$  แต่มีความหนาเพียง  $3.6\text{ nm}$  หรือความยาวเท่ากับ  $10$  หน่วยเซลล์  $20\%$  ของอะตอมอะอยู่ที่ผิวของทองแดง อิเล็กตรอนตัวนำจะเคลื่อนที่ได้ภายในแผ่นและถูกจำกัดทิศทาง ซึ่งก็คือ quantum well สำหรับ quantum wire รูปร่างจะยาวใน 1 มิติ อิเล็กตรอนจะสามารถเคลื่อนที่ได้เฉพาะตามความยาว และในส่วนของ quantum dot ไม่ว่าจะเป็นรูปร่างลูกบาศก์เด็กๆ ทรงกระบอกสันๆ หรือทรงกลมที่มีขนาดอยู่ในหน่วยนาโนเมตร อิเล็กตรอนอิสระก็จะถูกจำกัดการเคลื่อนที่ทั้ง 3 มิติ

### **2.5.3 Fermi Gas and Density of States**

เนื่องจากวัสดุที่มีขนาดเล็กมีผลทำให้เกิดสมบัติังกล่าว จึงทำให้นักวิจัยสนใจศึกษาเกี่ยวกับ Nano Technology เพื่อสามารถผลิตวัสดุพิเศษและนำไปประยุกต์ใช้กับสิ่งต่างๆทั้งภายในภาพ เช่น การทำให้วัสดุต่างๆ มีสมบัติตามที่ต้องการ เช่น ให้มีความแข็ง (Hardness) มีความเหนียวและมีน้ำหนักเบา เช่น อุปกรณ์กีฬา วัสดุที่ต้องการความแข็งแรง อ่อนเหนียว และมีน้ำหนักเบา วัสดุในเชิงอุตสาหกรรม ฯลฯ รวมทั้งในด้านการแพทย์และเวชกรรมชีวภาพ

## **2.6 ประเภทของวัสดุ nano และเทคนิคการสังเคราะห์**

โดยปกติประเภทของวัสดุ nano แบ่งออกได้เป็นหลายประเภท ขึ้นอยู่กับความต้องการนำไปใช้งาน เช่นวัสดุ nano บางชนิดให้เป็นส่วนผสมสำหรับเสริมแรงในเนื้อวัสดุ หรือบางชนิดใช้วัสดุ nano เพื่อทำฟิล์มนบางซึ่งวัสดุ nano แต่ละประเภทจะมีเทคนิคในการสังเคราะห์ที่แตกต่างกัน ออกไปขึ้นอยู่กับชนิดและเทคนิคการสังเคราะห์

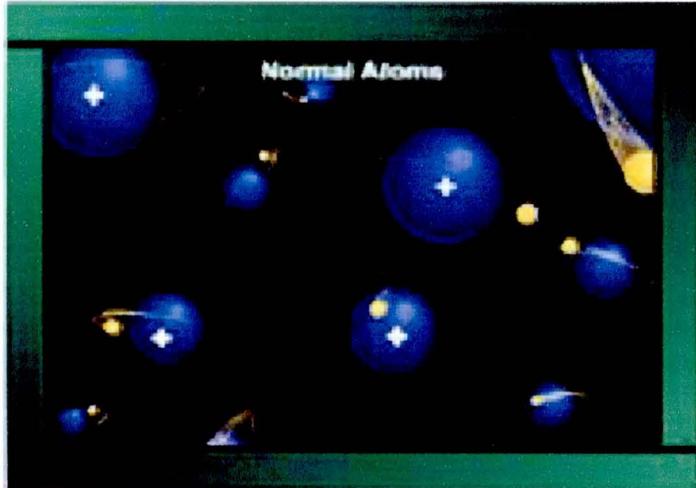
### **2.6.1 วัสดุ nano ประเภทฟิล์มนบาง (nano thin films)**

เป็นวัสดุ nano ในรูปแบบ nano well ที่มีขนาดเล็กลงในระดับนาโนเมตรเพียงหนึ่งมิติ แต่อีกสองมิติยังมีขนาดใหญ่ หรือเรียกว่าฟิล์มนบาง เช่นเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีความหนาของชั้นอนุภาคในระดับนาโนเมตร ซึ่งเทคนิคในการทำให้เกิดฟิล์มนบางมีหลากหลาย เช่น

#### **2.6.1.1 Arc Spray Technique [8]**

เป็นเทคนิคการทำให้เกิดฟิล์มนบางโดยใช้หลักการอาร์ค (arc) ลวดโลหะด้วยศักย์ไฟฟ้าแรงดันสูง เพื่อทำให้อิเล็กตรอนที่อยู่บริเวณปลายเส้นลวด โลหะถูกกระตุ้นและชนกับโนเมกุล ของอากาศบริเวณปลายเส้นลวด โลหะจะทำให้โนเมกุลของอากาศแตกตัวกลายเป็นไออ่อนบวก และลบดังรูปที่ 2.5 และรูปที่ 2.6

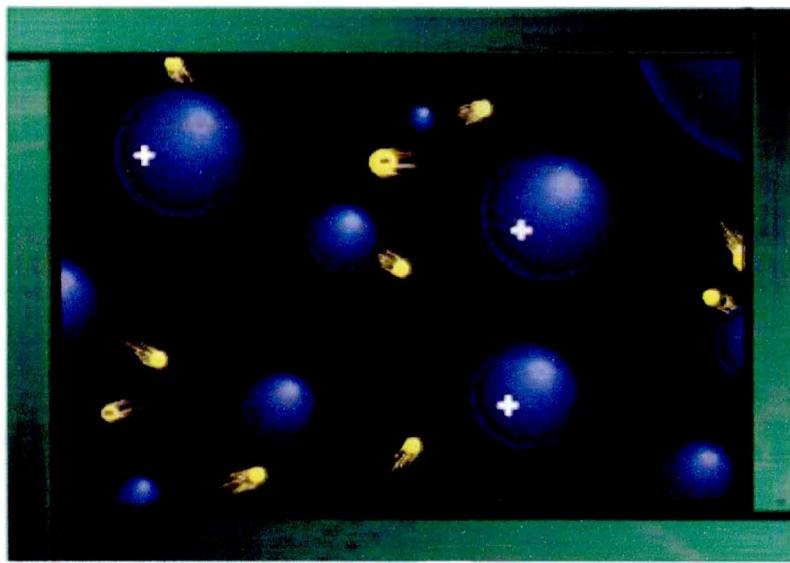
Normal atoms are charge neutral



รูป 2.5 อะตอมของอากาศในสภาวะปกติ [9]

Add some thermal energy

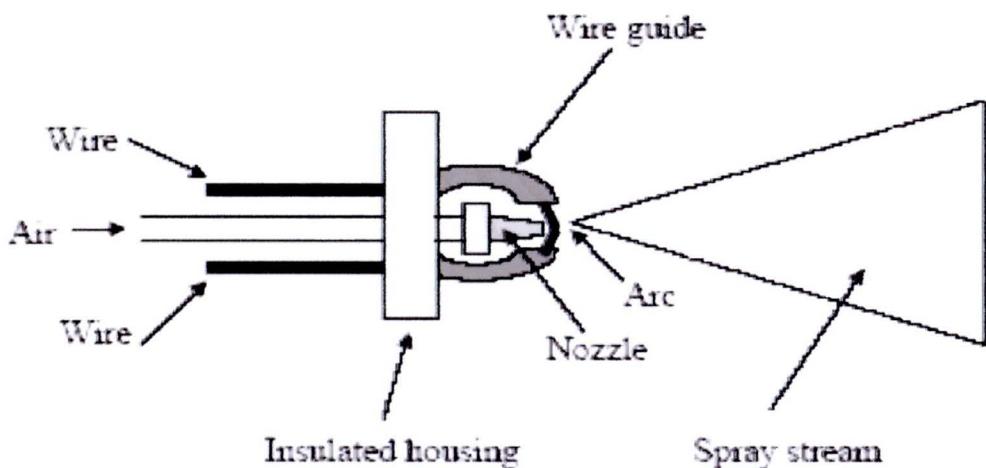
electrons acquire enough energy to escape from atomic binding forces => ions & electrons



รูป 2.6 อะตอมของอากาศเมื่อได้รับพลังงานสูงทำให้อิเล็กตรอนหลุดจากอะตอม [9]

เมื่ออะตอมเกิดการแตกตัว ไอออนบวกจะวิ่งชนปลายเส้นลวดด้านและโหนดจนทำให้เกิดความร้อนมากพอที่จะทำให้ก้อนอนุภาคเล็กๆ บริเวณปลายลวดโลหะหลุดออกมานอกปริมาณมาก จากรูปที่ 2.7 จะมีท่ออากาศ

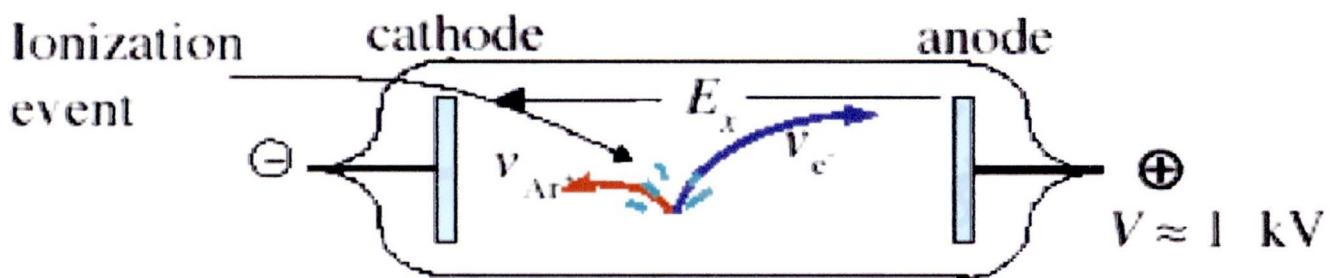
สำหรับพ่นอนุภาคที่หลุดให้เกาะติดกับ substrate ในลักษณะของฟิล์มบาง โดยเทคนิคนี้จะช่วยให้อนุภาคที่ถูกพ่นเกาะติดแน่นขึ้น



รูป 2.7 เทคนิคของ two-wire arc spray gun [8]

#### 2.6.1.2 Sputtering Technique [9]

เป็นกระบวนการเกิด ไออ่อนของ แก๊ส ในบรรยากาศ เกิดขึ้นด้วย ความต่างศักย์ไฟฟ้า ระหว่างขั่วแอโนดและขั่วแคโทด ดังรูปที่ 2.8



รูป 2.8 หลักการเกิด ionization ระหว่างขั่วแอโนดกับขั่วแคโทดของแก๊ส

กระบวนการเกิด ไออ่อน (break down) เริ่มขึ้นเมื่อความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างขั่วแอโนด และขั่วแคโทดมากกว่าพลังงานศักย์ของอะตอมของก๊าซ ดังสมการที่ 2.3



สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
วันที่ ๒๐ ก.ย. ๒๕๕๕
เลขทะเบียน ๒๑๙๖๙๔
เลขเรียกหนังสือ

$$V_{CD} \gg V_{breakdown} \Rightarrow ions (e.g. Ar^+ + e^-) \quad (2.3)$$

*Ions < 1% of atoms.*

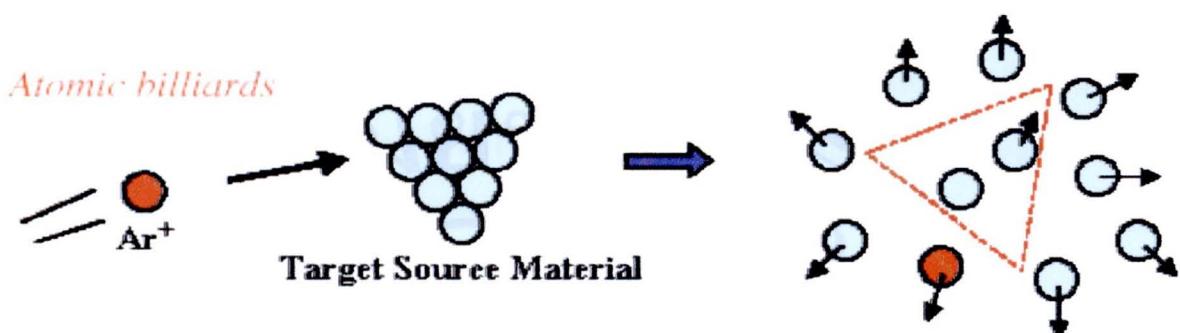
จากรูปที่ 2.8 ถ้าขั้วแคโทดเป็นเป้าโลหะ (target source material) ทำให้  $Ar^+$  วิ่งเข้าชน เป้าโลหะและอิเล็กตรอน ( $e^-$ ) วิ่งเข้าชนขั้วแอโนดที่ทำหน้าที่เป็น substrate ด้วยพลังงานจนดัง สมการที่ 2.4

$$E_{kin} \approx 1keV = \begin{cases} = \left(\frac{1}{2}\right) M_{Ar} V_{Ar}^2 = 916m_e V_{Ar}^2 \\ = \left(\frac{1}{2}\right) M_{e^-} V_e^2 = 916m_e V_e^2 \end{cases} \therefore V_{Ar} = \frac{V_e}{\sqrt{43}} \quad (2.4)$$

และมีการถ่ายเทโนเมนตัมดังสมการที่ 2.5

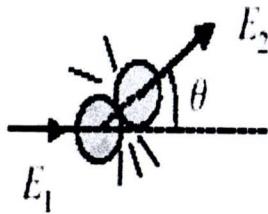
$$Momentum transfer \quad \begin{cases} P_{Ar} = MV = 1832 mv/43 \\ P_e = mv \end{cases} \quad (2.5)$$

กล่าวคือ เมื่อ  $Ar^+$  เคลื่อนที่เข้าชนเป้าโลหะที่ขั้วแคโทดที่แสดงดังรูปที่ 2.9



รูป 2.9 ลักษณะการชนกันของอะตอม

จากรูปที่ 2.9 จะเกิดการชนและถ่ายเทพลังงานแบบยึดหยุ่นขึ้น เป็นไปตามสมการที่ 2.6



$$\frac{E_2}{E_1} \propto \frac{4M_2 N_2}{(M_1 + M_2)} \cos^2 \theta \quad E_2 \text{ greatest for } M_1 \approx M_2 \quad (2.6)$$

กรณีของอิเล็กตรอน ( $e^-$ ) ที่วิ่งเข้าชน substrate ที่ขึ้นอยู่ในดิจิตอลของอิเล็กตรอนมีค่าน้อยกว่าความล廓ตอมของ substrate ( $M_1 \ll M_2$ ) จากสมการที่ 2.6 จะได้

$$\frac{E_2}{E_1} \approx \frac{4M_1}{M_2} \quad (\text{small}) \quad (2.7)$$

แต่อิเล็กตรอนจะให้พลังงานจน (E\_k) แบบไม่จำกัด ดังสมการจะเป็นไปตามสมการที่ 2.8

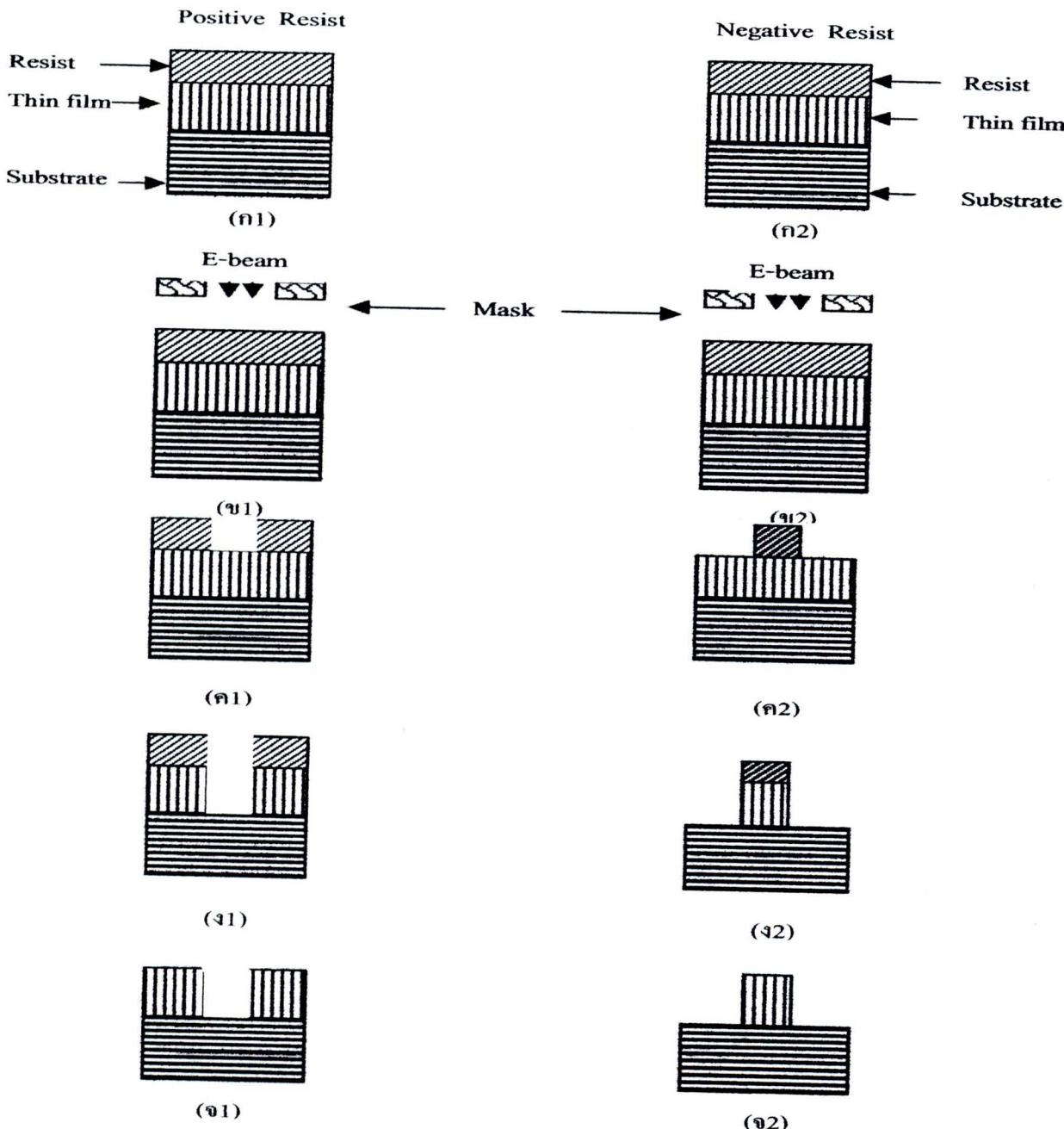
$$\frac{1}{2} M_e V_e^2 \Rightarrow \Delta U \quad (2.8)$$

### 2.6.2 วัสดุ nano ประเทกอนุภาค (nano dots) [10]

จุด nano (nano dot) หรือจุดควอนตัม (quantum dot) คือโครงสร้างขนาดเล็กที่สร้างขึ้นมาในของแข็ง โดยทั่วไปจะอยู่ในช่วงไม่เกิน 100 nm ในแต่ละดอทประกอบด้วยอะตอมประมาณ  $10^3$ - $10^9$  atom ซึ่งจะมีค่าพอกันกับจำนวนของอิเล็กตรอน ในเชิงคณิตศาสตร์ อิเล็กตรอนส่วนใหญ่จะยึดกับนิวเคลียสอย่างหนาแน่นจะมีอิเล็กตรอนอิสระเพียงเล็กน้อยหากอาศัย Current fabrication technology จะทำให้เราสามารถควบคุมขนาดและรูปร่างของดอทได้อย่างแม่นยำ ซึ่ง quantum dot มีรูปร่างหลายแบบ เช่น แท่งสามเหลี่ยม มีรูปร่างทรงกระบอก หรือเป็นแบบทรงกลม ขึ้นอยู่กับเทคนิคที่ใช้การทำให้เกิดดอท ซึ่งมีหลากหลายเทคนิคดังนี้

#### 2.6.2.1 Lithography Technique [7]

เป็นเทคนิคการสร้างควอนตัมดอท โดยการฉาบรองสีผ่านแบบลงบนพื้นผิวที่เคลือบด้วยสารไวต่อรังสี ซึ่งจะถูกถ่ายออกไปโดยกระบวนการทางเคมี เพื่อให้เกิดควอนตัมดอท สารไวต่อรังสีทั่วไปที่ใช้คือ polymer polymethyl metacrylate ( $C_5O_2H_9$ )\_n ที่มีมวลโมเลกุลอยู่ระหว่าง  $10^5$  -  $10^6$  Da ( daltons ; g/mol ) กระบวนการ lithography จะทำให้ควอนตัมดอทนี้ลักษณะเป็นทรงสี่เหลี่ยมบางอยู่บนชั้นสเตรต



รูป 2.10 กระบวนการ Lithography [7] (ก1-ก4) ใช้ resist แบบ positive (ก2-ก4) ใช้ resist แบบ negative

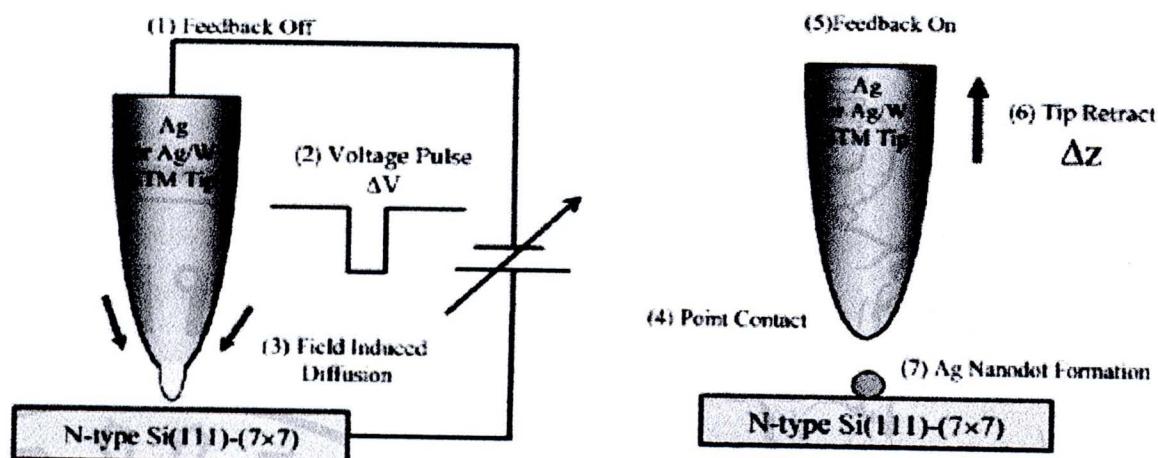
- ตักขยะฟิล์มบางบนแผ่นรองรับ และมี resist อยู่ด้านบนก่อนที่จะทำการทดลอง
- นำรังสีผ่านแบบบลอกบนชิ้นงาน
- ใช้กระบวนการทางเคมีล้าง resist ในส่วนที่โคนแสง สำหรับ resist แบบ positive และส่วนที่ไม่โคนแสงสำหรับ resist แบบ negative ออกไป

- (ก) ลักษณะชิ้นงานที่ได้หลังจากล้างฟิล์มบางในส่วนที่ไม่มี resist ปิดออกໄປ  
 (ข) ชิ้นงานที่ได้หลังจากล้าง resist ออกໄປ ซึ่งจะได้จุดความตันตามตำแหน่งที่ออกแบบ  
 ไว้ซึ่งจะเหมือนกับ mask

ขั้นแรกของการกระบวนการ lithography คือ การวางแผน resist ลงบนชิ้นงานตามรูปที่ (ก) หลังจากนั้นชิ้นงานจะถูกยิงด้วยลำอิเล็กตรอนผ่าน mask ซึ่งมีลักษณะต่างๆ ซึ่งจะทำให้สารไวต่อรังสีโคนลำอิเล็กตรอนเฉพาะในส่วนที่ต้องการคั่งรูป (ข) ขั้นที่ 3 จะเป็นการใช้กระบวนการทางเคมีเพื่อกำจัดสารไวต่อรังสีออกไปดังรูป (ค) ขั้นที่ 4 กำจัดส่วนของฟิล์มบางในบริเวณที่ไม่มี mask ปิดออกໄປและขั้นตอนสุดท้ายส่วนของ mask ก็จะถูกกำจัดออกໄປ จึงเหลือเฉพาะจุดความตันทรงสี่เหลี่ยมในบริเวณที่ออกแบบไว้

### 2.6.2.2 STM-Based Fabrication Technique

D. Fujita และ T. Kumakura [11] ได้ทำการสร้างความตันด้วยอาศัย tip ของกล้องจุลทรรศน์ทะลวงการ (Scanning Tunneling Microscopy หรือ STM) จะมีส่วนของ tip บางส่วนไปเกาะอยู่บนสับสเตรต หลังจากให้พัลส์ของความต่างศักย์ในการทดลองนี้เป็นการทำให้เกิดความตันด้วยเงินลงบันผิวของ Si(111)-(7×7)



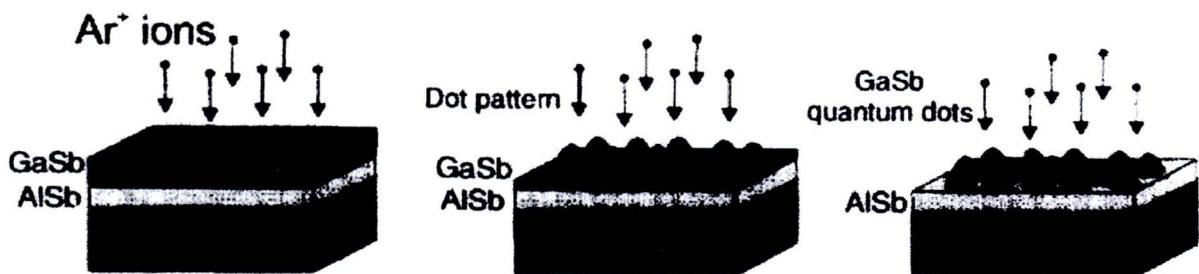
รูป 2.11 กระบวนการ tip material transfer mechanism ของเงินลงบัน n-Si (111) โดยการให้พัลส์ของความต่างศักย์ ซึ่งกระบวนการนี้ทำในระบบ ultra high vacuum (UHV) [11]

- (A) ให้พัลส์ความต่างศักย์แก่ tip และชับสเตรตหลังจากปีระบบ feedback control ส่วนที่ขาวขึ้นมากพอที่จะสัมผัสกับผิวของชับสเตรตในระหว่างการจ่ายให้ความต่างศักย์  $\Delta V$
- (B) เมื่อสิ้นสุดการจ่ายพัลส์จะทำให้ระบบ feedback control กลับมาทำงานอีกครั้ง ซึ่งจะยก tip ขึ้นให้หลุดจากผิวของชับสเตรต ทำให้เกิดความตันดอทขึ้นบนผิวของชิลิกอน

จากรูปที่ 2.11 กระบวนการ tip - material transfer จาก tip ของเงินลงบันผิว Si (111) ทำได้โดยวาง tip เหนือชับสเตรต โดยใช้ระบบ feedback control ซึ่งโดยทั่วไปจะอยู่ที่ความสูงประมาณ 1 มิลลิเมตร หลังจากปีระบบ feedback control จ่ายพัลส์ของความต่างศักย์ให้ tip คลอดช่วงเวลาของพัลส์จะมี tunneling current เกิดขึ้นซึ่งสามารถตรวจได้โดยกล้องดิจิตอล ของศูนย์โลสโคลป์ ซึ่งว่าระหว่าง tip และชับสเตรตจะลดลงเรื่อยๆ เนื่องจากส่วนของ tip ที่ขาวขึ้น เมื่อระบบห่างอยู่ในระบบที่เหมาะสม สังเกตจากกระแส  $\mu A$  ส่วนปลายของ tip จะแพร่ไปเก้าอี้ดอทที่ผิวของชิลิกอน เมื่อ tip ถูกยกขึ้นก็จะทำให้เกิดความตันดอทบนผิวของชิลิกอนซึ่งจะไม่หลุดออกมานอกจากพื้นฐานเคมีระหว่างอะตอมของเงินและอะตอมของชิลิกอนยึดเกาะไว้

### 2.6.2.3 Iron Sputtering Technique

S.Facsko [12] และคณะได้ทำการพานิช化ความตันดอทขึ้นโดยการใช้ Molecular Beam Epitaxy (MBE) ลายลงบนผิวของ GaSb ซึ่งวางอยู่บนชับสเตรตชนิดอิน (AlSb , GaAs)  $Ar^+$  ที่มีพลังงานระหว่าง 100 eV - 2 keV จะถูกปล่อยลงสู่ผิวของชับสเตรตด้วยอัตรา  $1 \times 10^{16} \text{ cm}^{-2}\text{s}^{-1}$  การทดลองจะทำที่อุณหภูมิ  $60^\circ\text{C}$  และ  $-100^\circ\text{C}$  โดยหล่อเย็นด้วยไนโตรเจนเหลว ตักษณะของความตันดอทที่เกิดขึ้นบนผิวของ GaSb ขึ้นอยู่กับเวลาที่ใช้ในการฉายไอออน ทำให้ความตันดอทที่ได้มีขนาดเฉลี่ย 26 nm และมีความหนาแน่น  $6 \times 10^{10} \text{ cm}^{-2}$  กระบวนการ fabrication ความตันดอทสามารถแสดงดังรูปที่ 2.10



รูป 2.12 หลักการเกิดความตั้มดอทโดยอาศัยหลักการ Iron Spattering [12]

ความตั้มดอทจะเริ่มก่อตัวหลังจากยิงไออกอน ขนาดและความสูงของความตั้มดอทจะเพิ่มขึ้นตามเวลาที่ใช้ของไออกอนในขณะที่ความหนาแน่นของความตั้มดอทยังคงที่ หลังจากยิงไออกอน 400 วินาที โครงสร้างพื้นผิวจะก่อตัวเป็น close-packed hexagonal

## 2.7 สรุปสาระสำคัญจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง

สำหรับข้อมูลของการศึกษาการเตรียมฟิล์มนางอะลูมิเนียมออกไซด์ซึ่งมีสมบัติกันสะท้อนสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ในปี ค.ศ. 2004 Z.W. Zhao และคณะ [13] ได้ทำการทดลองศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิ การอบอ่อนที่มีต่อสมบัติเชิงแสงและโครงสร้างของฟิล์มนางอะลูมิเนียมออกไซด์ที่เตรียมจากวิธีการแคร็คิคาวาร์กในสูญญากาศแบบมีฟิลเตอร์ โดยพบว่าเมื่อใช้อุณหภูมิที่ใช้ในการอบอ่อนสูงขึ้นจะส่งผลให้สมบัติเชิงแสงของฟิล์มนางดีขึ้น ซึ่งจากการทดลองพบว่าที่อุณหภูมิการอบอ่อน 600 องศาเซลเซียสนั้นจะส่งผลให้ฟิล์มนางอะลูมิเนียมออกไซด์มีค่าการส่งผ่านของแสงที่สูงที่สุด อีกทั้งโครงสร้างของฟิล์มนางที่ได้นั้นยังคงเป็นอัลตราโนนและมีพินคิวที่เรียบเงางามกว่าเดิม แต่ยังไร้กีต้ำกึ่งพบร่วมกับการอบอ่อนที่อุณหภูมิสูงกว่า 900 องศาเซลเซียส แล้วจะส่งผลให้สมบัติเชิงแสงและโครงสร้างของฟิล์มนางอะลูมิเนียมออกไซด์นั้นเปลี่ยน

ต่อมาในปี ค.ศ. 2006 Naoko Yamaguchi และคณะ [14] ได้ทำการศึกษาสมบัติกันสะท้อนของฟิล์มนางอะลูมินาที่มีลักษณะคล้ายดอกบันชับสเตรตซึ่งเป็นแก้วซิลิกาโซดาไลน์ที่

เตรียมได้จากวิธีการโซล-เจลและการแห้งน้ำร้อน พบว่ามีการเกิดผลึกนาโนของ pseudoehmite บนพื้นผิวฟิล์ม ทั้งความสะท้อนที่ช่วงความยาวคลื่น 360-620 นาโนเมตร ของฟิล์มหลังจากการนำไปเปลี่ยนน้ำร้อนเป็นเวลา 30 นาที น้ำมีค่าน้ำอยกว่า 0.5% รวมไปถึงความหมายผิวของฟิล์มนางอะลูมิเนียมออกไซด์นั้นจะน้อยลงด้วย

สำหรับข้อมูลของการศึกษาเกี่ยวกับการเตรียมฟิล์มนางนาโนที่ได้จากการกระบวนการสปาร์ค นั้นสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ในปี ก.ศ. 2007 T. Kumpika และคณะ [15] ได้ทำการศึกษาถึงสมบัติเชิงแสงและเชิงไฟฟ้าของฟิล์มนางอนุภาคนาโนซึ่งคือออกไซด์บันคือตัวซึ่งเตรียมจากการกระบวนการสปาร์ค โดยทำการ สปาร์คลวดซึ่งคือบันชับสเตรตที่เป็นก่อตัวจำนวน 50-200 ครั้ง ด้วยความต่างศักย์สูงประมาณ 10 กิโลโวลต์ในสภาพแวดล้อมรากอากาศปกติ โดยมีอัตราการสะสมของฟิล์มเป็น 1 นาโนเมตร ต่อการสปาร์ค 1 ครั้ง หลังจากการตรวจสอบด้วยการเดี่ยวเบนรังสีเอกซ์, สเปกโทรสโคปีแบบรaman, UV-vis spectrophotometry และ ionoluminescence ที่อุณหภูมิห้อง พบว่าเมื่อนำฟิล์มนางอนุภาคนาโน ซึ่งคือออกไซด์มาทำการอบอ่อนที่อุณหภูมิ 400-800 องศาเซลเซียส จะปรากฏพิคการปลดปล่อยพลังงานที่ความยาวคลื่น 483 (แสงสีเขียว) และ 650 (แสงสีส้มแดง) นาโนเมตร อีกทั้งสภาพด้านท่านไฟฟ้าของฟิล์มนั้นเป็นสัดส่วนกับความเข้มของพิคการปลดปล่อยพลังงานของแสงสีส้มแดงด้วย

ต่อมาในปีเดียวกัน W. Thongsuwan และคณะ [16] ได้ทำการศึกษาถึงสมบัติโฟโตแคตái ติกของอนุภาคคือตัวซึ่งคือนาโนไทยเนี่ยม ได้ออกใช้ตัวที่เตรียมได้จากการกระบวนการสปาร์ค โดยอนุภาคนาโนไทยเนี่ยมออกไซด์ที่ได้หลังจากการสปาร์คลวดไทยเนี่ยมในน้ำเป็นเวลา 1-5 ชั่วโมง มีขนาดอนุภาคประมาณ 1-5 นาโนเมตร และหลังจากการตรวจสอบด้วยเทคนิครูปแบบการเดี่ยวเบนของอิเล็กตรอนและสเปกโทรสโคปีแบบรaman พบว่าอนุภาคนาโนคือตัวซึ่งคือไทยเนี่ยมออกไซด์ที่ได้หลังถูกนำไปอบอ่อนที่อุณหภูมิ 250 องศาเซลเซียส จะปรากฏเฟสอะนาเทสเกิดขึ้น แต่ย่างไรก็ตามหากทำการอบอ่อนที่อุณหภูมิต่ำกว่า 500 องศาเซลเซียส แล้วจะส่งผลให้มีการเปลี่ยนเฟสจากอะนาเทสไปเป็นรูไทล์เกิดขึ้นได้